

电子

周跟踪 (20240819-20240825)

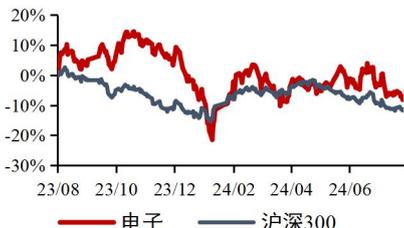
领先大市-A(维持)

AI 需求强劲带动晶圆代工复苏明显, AMD 收购服务器制造商 ZT

2024 年 8 月 26 日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】折叠屏+AR 智能眼镜催化, 继续看好消费电子板块机会-山西证券电子行业周跟踪 2024.8.19

【山证电子】晶圆代工双雄最新业绩亮眼, 半导体市场出现企稳复苏信号-山西证券电子行业周跟踪 2024.8.12

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周 (2024.08.19-08.23) 市场普遍下跌, 上证指数跌 0.87%, 深圳成指跌 2.01%, 创业板指跌 2.80%, 科创 50 跌 2.76%, 申万电子指数跌 2.86%, Wind 半导体指数跌 4.79%, 外围市场费城半导体指数涨 1.13%, 台湾半导体指数跌 1.44%。细分板块中, 周涨跌幅前三为其他电子 (+3.16%)、消费电子 (-0.50%)、光学光电子 (-2.00%)。从个股看, 涨幅前五为深圳华强 (+61.01%)、力源信息 (+43.04%)、晶赛科技 (+41.69%)、云里物里 (+33.69%)、*ST 同洲 (+24.83%); 跌幅前五为: 星星科技 (-30.28%)、亚世光电 (-27.24%)、纬达光电 (-25.18%)、凯旺科技 (-24.51%)、联建光电 (-22.53%)。

➢ **行业新闻:** AMD 以 49 亿美元收购服务器制造商 ZT Systems。ZT Systems 是全球最大超大规模计算公司领先的 AI 基础设施提供商, 拥有丰富的 AI 系统专业知识, 可与 AMD 芯片和软件功能形成互补。这项交易标志着 AMD 人工智能战略的下一个重要步骤, 即提供基于跨芯片、软件和系统的领先训练、推理解决方案。预估 2030 年 AR 装置出货量预计达 2,550 万台, LEDoS 技术将成为主流。受 AR 装置品牌厂的产品规划推动, 以及 AI 技术和应用生态系统发展的助力, 预估 2030 年 AR 装置出货量将达 2,550 万台, 2023 至 2030 年的年复合增长率为 67%。其中, LEDoS 在这一领域的渗透率将逐步提高, 到 2030 年有望达到 44%, 成为市场的主流技术。2024 年第二季度全球晶圆代工收入环比增长约 9%, 同比增长 23%。环比增长主要是由强劲的 AI 需求推动。CoWoS 供应仍然紧张, 未来产能扩张的潜在上行空间将集中在 CoWoS-L 上。尽管非 AI 半导体 (例如用于汽车和工业应用的半导体) 的需求恢复较慢, 但某些应用 (例如物联网和消费电子产品) 出现了一些紧急订单。

➢ **重要公告:** 【中微公司】2024 年上半年, 公司实现营业收入 34.48 亿元, 同比增长 36.46%, 实现归母净利润 5.17 亿元, 同比减少 48.48%。【兆易创新】2024 年上半年, 公司实现营业收入 36.09 亿元, 同比增长 21.69%, 实现归母净利润 5.17 亿元, 同比增长 53.88%。【沪电股份】2024 年上半年, 公司实现营业收入 54.24 亿元, 同比增长 44.13%; 实现归母净利润 11.41 亿元, 同比增长 131.59%。

投资建议

➢ 尽管整体逻辑半导体市场复苏较慢, 但晶圆代工产业仍然表现出强劲的反弹, 这主要得益于 AI 需求强劲, CoWoS 供应持续紧张。AMD 收购 ZT 反映了 AI 芯片厂商对跨芯片、软件和系统能力的重视, 并正加速布局 AI 基础设施。加码投资还体现了美股科技巨头对 AI 未来还是充满信心和重视。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代, AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求, 及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

➢ 风险提示

下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

图表目录

图 1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2: 周涨跌幅其他电子、消费电子、光学光电子表现领先.....	4
图 3: 月涨跌幅其他电子、光学光电子、消费电子表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4: 年初至今涨跌幅元件、半导体设备、消费电子表现领先.....	5
图 5: 多数板块当前 P/E 低于历史平均值.....	5
图 6: 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7: 本周个股涨幅前五.....	6
图 8: 本周个股跌幅前五.....	6
图 9: 全球半导体月度销售额及增速.....	6



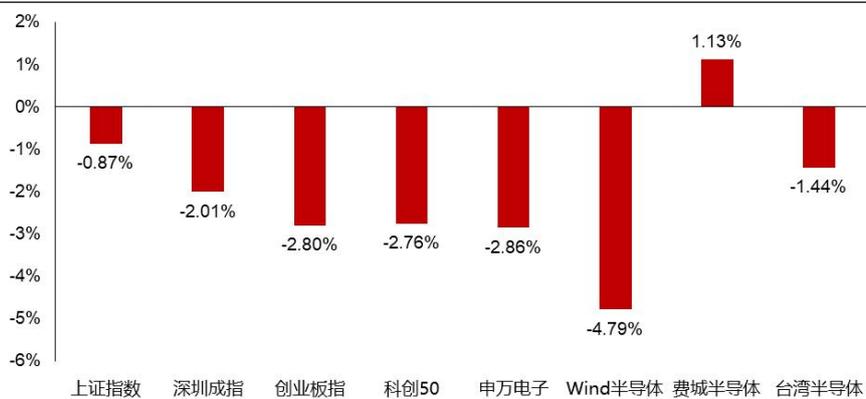
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.08.19-08.23）市场普遍下跌，上证指数跌 0.87%，深圳成指跌 2.01%，创业板指跌 2.80%，科创 50 跌 2.76%，申万电子指数跌 2.86%，Wind 半导体指数跌 4.79%，外围市场费城半导体指数涨 1.13%，台湾半导体指数跌 1.44%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

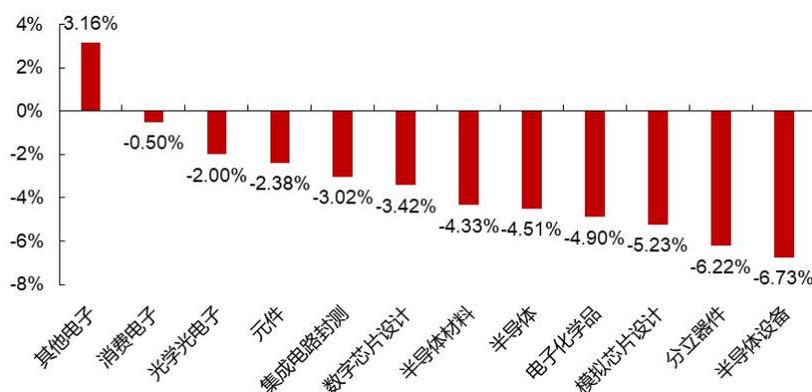


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

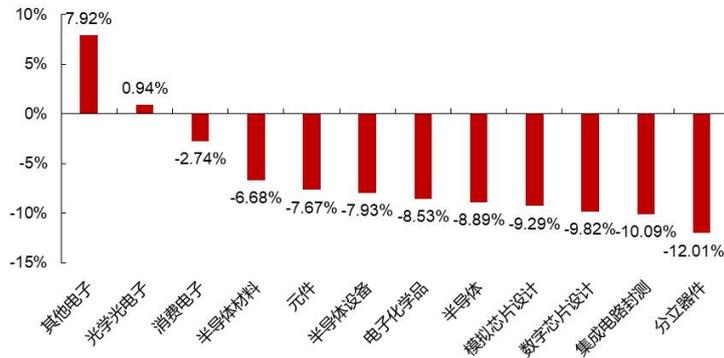
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅其他电子、消费电子、光学光电子表现领先



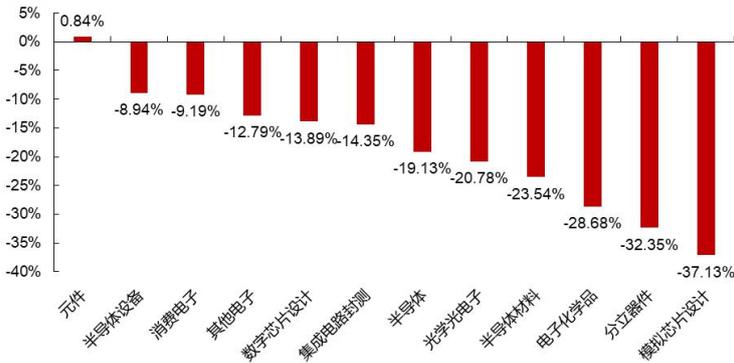
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅其他电子、光学光电子、消费电子表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

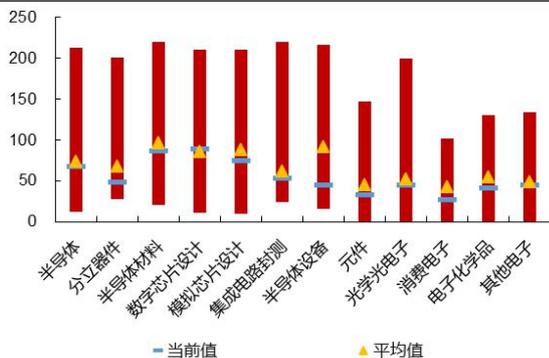
图 4：年初至今涨跌幅元件、半导体设备、消费电子表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

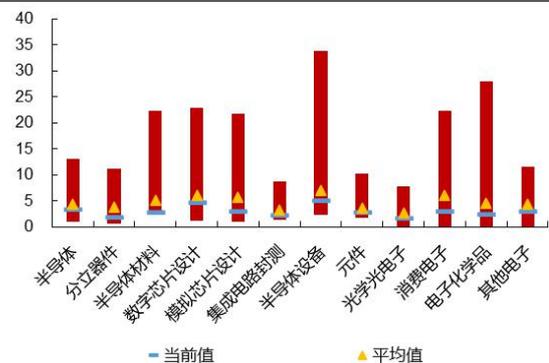
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 低于历史平均值



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

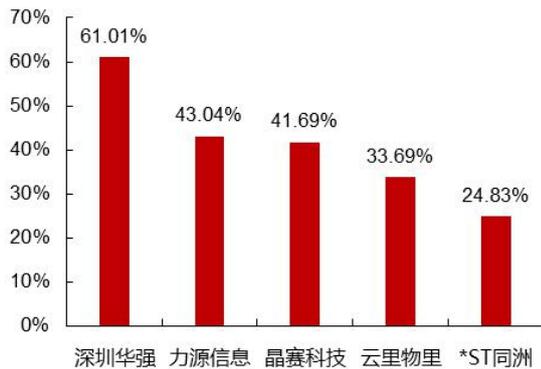


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

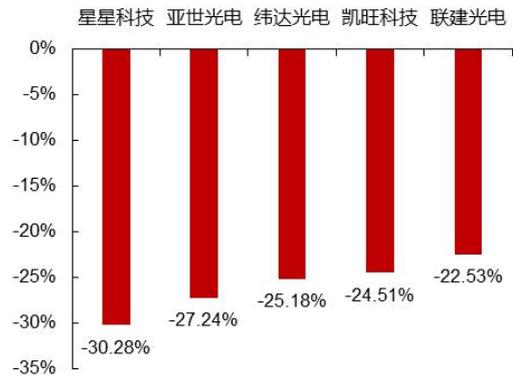
从个股情况看，深圳华强、力源信息、晶赛科技、云里物里、*ST同洲涨幅领先，涨幅分别为61.01%、43.04%、41.69%、33.69%、24.83%；星星科技、亚世光电、纬达光电、凯旺科技、联建光电跌幅居前，跌幅分别为30.28%、27.24%、25.18%、24.51%、22.53%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

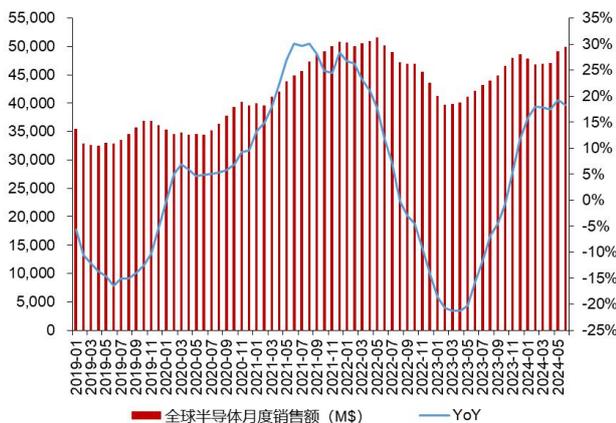
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

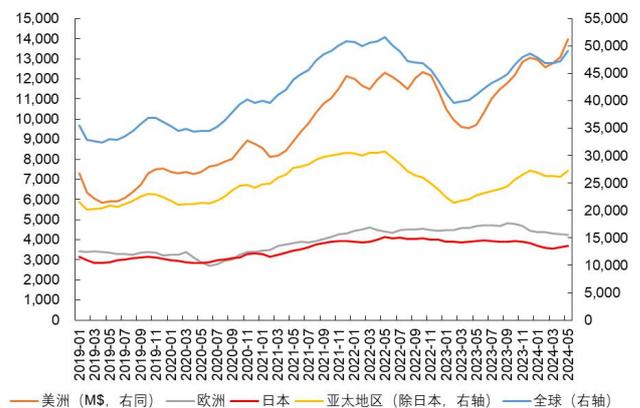
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



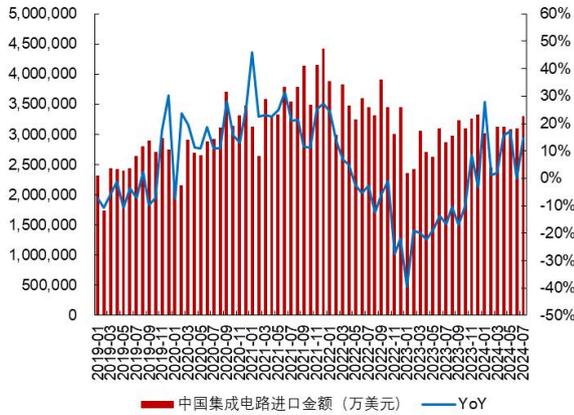
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



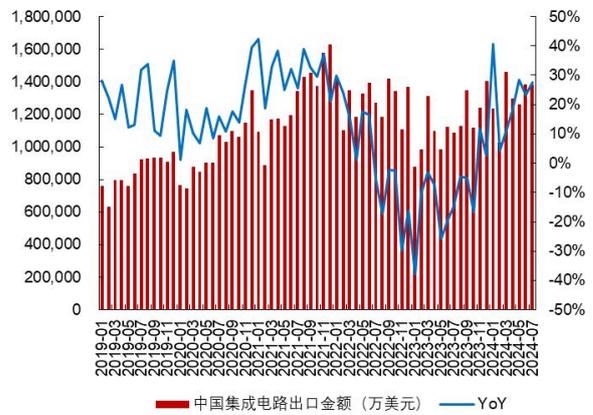
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11: 中国集成电路行业进口情况



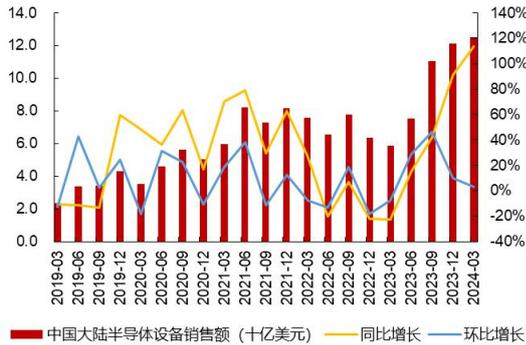
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 12: 中国集成电路行业出口情况



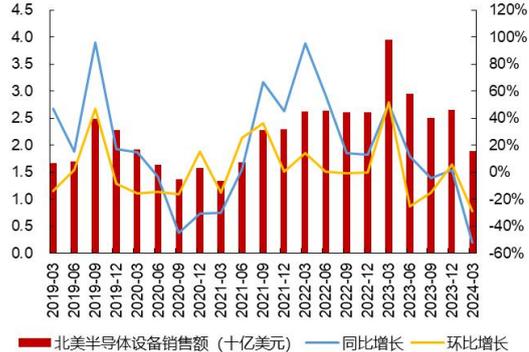
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 13: 中国大陆半导体设备销售额



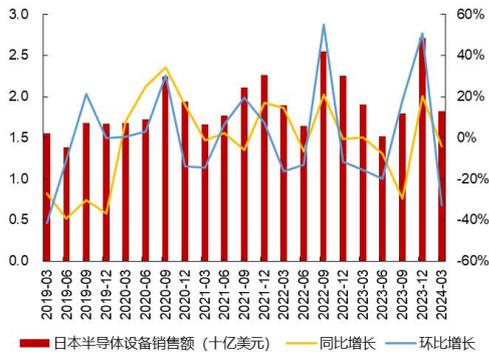
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 14: 北美半导体设备销售额



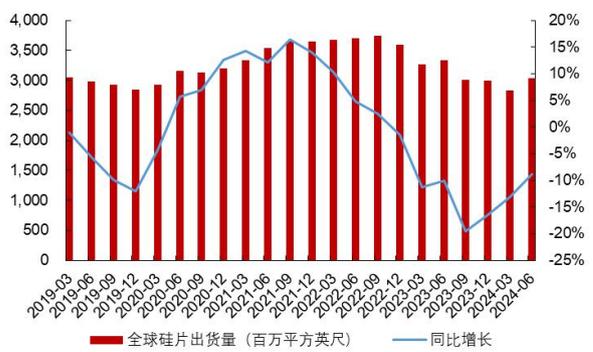
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 15: 日本半导体设备销售额



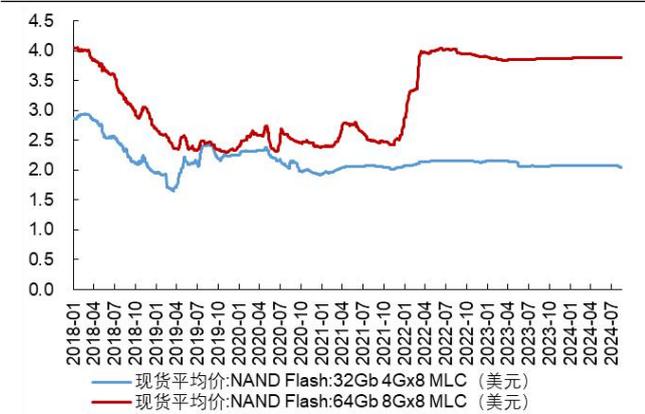
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 16: 全球硅片出货面积



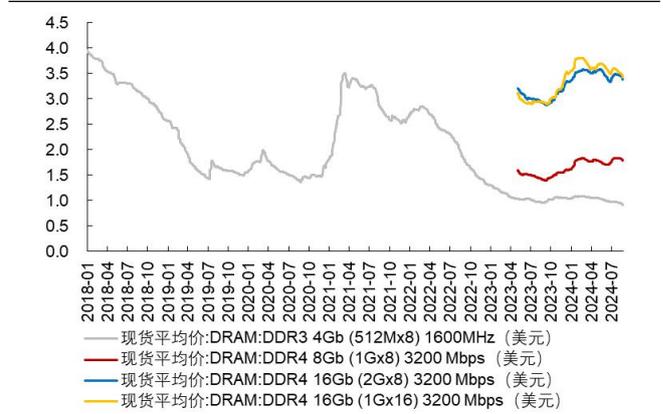
资料来源: SEMI, 山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



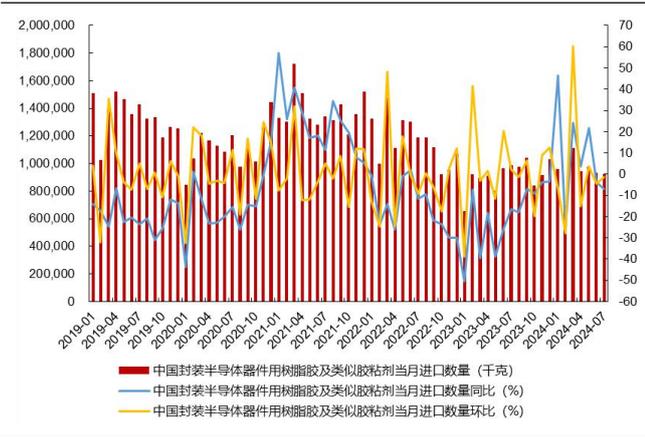
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



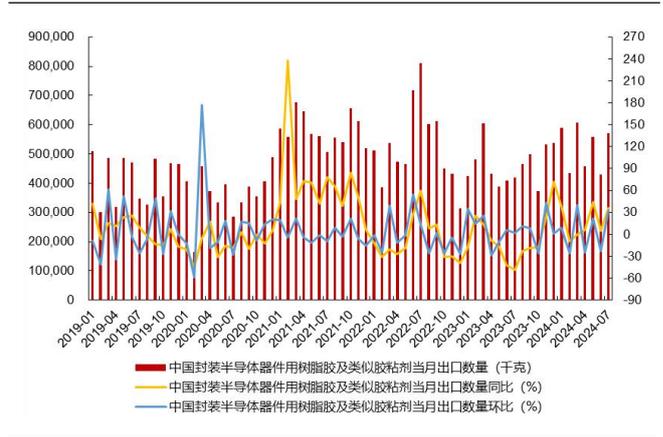
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



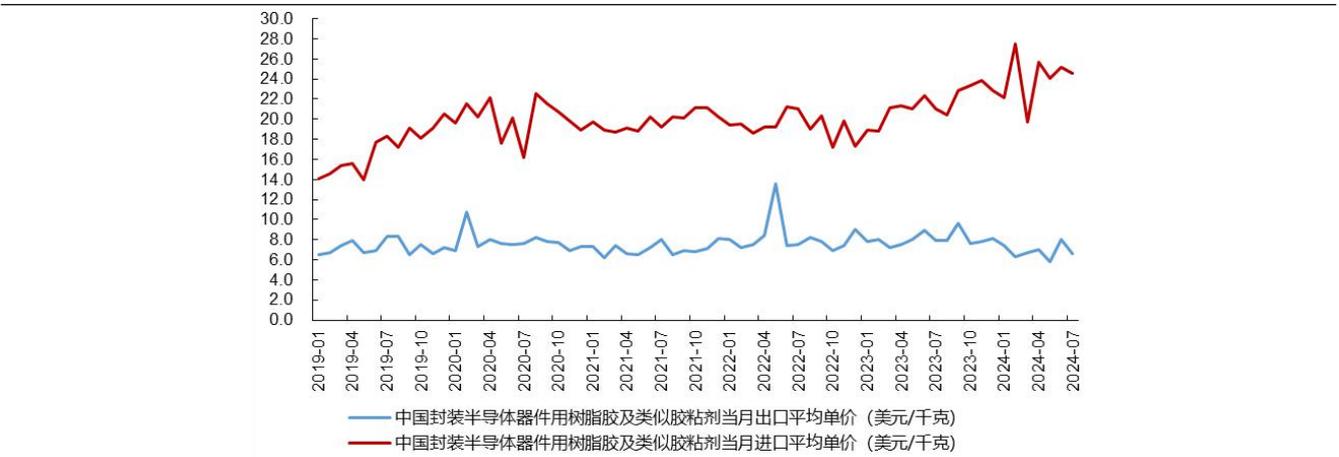
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



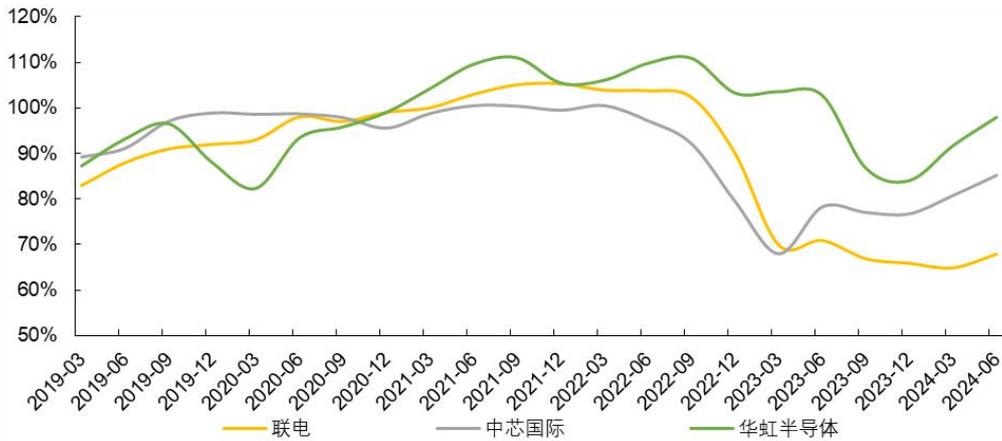
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



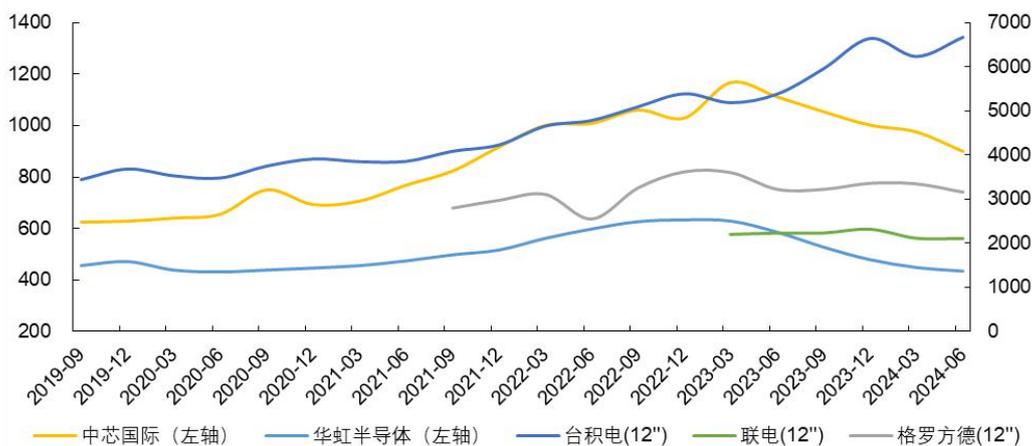
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 8 月 19 日					
2024 年 8 月 20 日				捷邦科技	

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年8月21日		中石科技、凯华材料			
2024年8月22日	徕木股份	伊戈尔	盈趣科技、信维通信、康希通信、兆易创新		
2024年8月23日			和而泰		
2024年8月24日		创耀科技、力源信息、广钢气体	思特威-W、明阳电路		

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年8月19日	WiFi 7 产品渗透率续增，2027 年突破五成。 国际研究机构 Gartner 认为，2024 年 WiFi 7 市场渗透率可望达 10%，预估 2027 年可望超过五成到 54%。MarketDigits 则预估，2023 到 2030 年 WiFi 7 年复合成长率将超过五成，市场产值将达 262 亿美元。市场正从 WiFi 6 转换至 WiFi 6E，但 AI 兴起，智能手机及笔记型电脑等旗舰品都支援 WiFi 7，加上 AIoT 等多元物联网产品蓬勃发展，更将加快 WiFi 7 成长速度。下半年 WiFi 7 相关产品可望量产出货，2025 年出货增温，真正驱动 WiFi 7 快速普及关键仍在价格，从芯片报价到终端售价，一旦触及甜蜜点，拉近与 WiFi 6 价差，从电信、企业端到消费者都将加速升级。	半导体产业纵横
2024年8月19日	AMD 拟通过现金加股票的方式，以 49 亿美元收购服务器制造商 ZT Systems。 AMD 已同意用价值 49 亿美元的现金和股票收购 ZT Systems。ZT Systems 是全球最大超大规模计算公司领先的 AI 基础设施提供商，拥有丰富的 AI 系统专业知识，可与 AMD 芯片和软件功能形成互补。ZT Systems 总部位于新泽西州西考卡斯，拥有超过 15 年的为全球最大云计算公司设计和部署数据中心 AI 计算和存储基础设施的经验。这项交易标志着 AMD 人工智能战略的下一个重要步骤，即提供基于跨芯片、软件和系统的领先训练、推理解决方案。	AMD
2024年8月19日	预估 2030 年 AR 装置出货量预计达 2,550 万台，LEDoS 技术将成为主流。 受 AR 装置品牌厂的产品规划推动，以及 AI 技术和应用生态系统发展的助力，预估 2030 年 AR 装置出货量将达 2,550 万台，2023 至 2030 年的年复合增长率为 67%。其中，LEDoS 在这一领域的渗透率将逐步提高，到 2030 年有望达到 44%，成为市场的主流技术。AR 装置热度正逐年攀升，除了 Apple、Meta 等国际品牌未来有相关产品计划外，中国厂商在 LEDoS 领域的投入也较为活跃。	TrendForce
2024年8月20日	三星电子今年底启动 HBM4 内存流片，为明年底量产做准备。 三星电子将在 HBM4 内存上采用 1c nm 制程 DRAM 颗粒和 4nm 制程逻辑芯片，以提升产品能效表现，也方便在逻辑芯片中引入更丰富功能支持。考虑到从流片到测试产品的推出还需要 3 到 4 个月的时间，三星电子的 HBM4 12Hi 样品预计最早明年初亮相。三星电子此后将对样品进行功能验证并改进设计和工艺，改进后的样品将向主要客户出样。	The Elec

时间	内容	来源
2024年8月20日	2024年第二季度全球晶圆代工行业收入环比增长约9%，同比增长23%。环比增长主要是由强劲的AI需求推动的。CoWoS供应仍然紧张，未来产能扩张的潜在上行空间将集中在CoWoS-L上。尽管非AI半导体（例如用于汽车和工业应用的半导体）的需求恢复较慢，但我们观察到某些应用（例如物联网和消费电子产品）出现了一些紧急订单。值得注意的是，与全球同行相比，中国的代工和半导体市场复苏更快。中芯国际和华虹等中国晶圆代工企业公布了强劲的季度业绩和积极的指引，因为中国的无晶圆厂客户更早进入库存调整阶段，比全球同行更早触底。2025年，台积电5/4nm和3nm等尖端节点的晶圆价格可能会上涨，这预示着代工行业的长期增长。	Counterpoint
2024年8月21日	西部数据正在剥离其NAND和SSD业务，业务剥离后估值可能与Solidigm相似，业务的价值在100亿~220亿美元之间。西部数据将拆分为两个不同的业务部门，一个部门生产硬盘驱动器（HDD），另一个部门生产NAND闪存和SSD。西部数据的NAND和SSD业务作为独立业务的价值可能在100亿~220亿美元之间。	TrendForce

资料来源：半导体产业纵横，AMD，TrendForce，The Elec，Counterpoint，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区金田路 3086 号大百汇广场 43 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

